

HP / December 29, 2009 12:19AM

[從零到英雄 台大進攻 ISSCC 雪恥 / 中國時報](#)[2009-12-28 中國時報](#) 李宗祐 / 台北報導

「我把台灣在 I S S C C (國際固態電子電路會議) 的故事，稱之為『From Zero To Hero』(從零到英雄)。」台大電子工程研究所長呂學士表示，七年前，國外媒體嘲諷台灣被 I S S C C 「三振出局」，現在「我們的表現讓他們震驚了！」

呂學士指出，二〇〇二年二月《EE

Times》以「[台灣被 I S S C C 三振出局](#)

」*，報導台灣在該會議發表研究論文篇數「掛蛋」。除了嘲諷，他們更好奇的是，台灣當時已是全世界 I C 設計重鎮，產值在全球排名第二，為何從未在國際最重要的晶片設計奧林匹克競賽發表研究論文？

《EE Times》笑我被三振出局

「當時鈺創科技董事長盧超群點出台灣的最大問題，並不是什麼事都沒做，而是沒有做得比人家好，主要在於沒有創意！」呂學士表示，盧超群找上台大，直說「人家都在譏笑我們了，台大總要有些動作吧。」當時的電子所所長陳良基召集多位教授檢討問題。

呂學士指出，台灣學術界傳統上重視在學術期刊發表論文，不重視在國際會議發表論文，也不了解 I S S C C 在國際間這麼有影響力。歷經《EE Times》事件後，台大電子所決定變法、打破傳統，將 I S S C C 設定為目標會議，規定學生若在會議發表論文，就符合博士畢業資格，從此全面「進攻」I S S C C。

隔年，呂學士和同所教授劉深淵、交大電子所教授吳介琮就連袂在該會議發表三篇論文，完成「破蛋」任務。呂學士指出，那時國科會和教育部共同推動「國家矽導計畫」，加上後來的「五年五百億」，讓台大有機會延攬多位海外歸國學人，並增額招收碩博士生，吸收更多優秀學子。

呂學士等發表論文 率先「破蛋」

C I C 主任魏慶隆則表示，在美國，學者要把構想和創意「變成」晶片，若要使用最先進的奈米製程，花費非常昂貴，沒有充足的經費支持，很難做出來。在台灣，C I C 免費提供電腦輔助設計軟體，學界設計好後，由台積電、聯電等廠商協助以先進奈米製程製成晶片及封裝，再拿到 C I C 測試。

「台灣學者近年能夠在晶片設計競賽嶄露頭角，因為有 C I C 幫學界作好策略布局，加上半導體業者提供先進製程支援。」C I C 主任魏慶隆指出，另一個關鍵在於，台積電和聯發科近年陸續捐款大學建置實驗室，並把業界須要什麼產品告訴學者，讓他們找到好的研究題目。

相關文章：

[\[電機電子\] 九篇台灣論文入圍IEEE固態電路學會](#) 2009.11.26

[台大研發微晶片 為背痛患者捎福音 \(真不是蓋的\)](#) 2009.11.26

* A Quote from the EE Times article:

Lu (盧超群) agreed that Taiwan's success in manufacturing has drawn the best talent away from research and more toward development.

[hr]

[新聞辭典 - ISSCC 國力強弱競技場](#)

2009-12-28 中國時報 李宗祐整理

國際固態電子電路會議 (I S S C C) 每年在美國舊金山舉行，是 I C 設計界最高盛會，又稱「晶片奧林匹克競賽」，英特爾和 I B M 等國際重量級廠商及麻省理工學院、柏克萊大學等全球知名大學，都選擇在此會議發表重大技術和研究成果。

國家晶片系統設計中心主任魏慶隆指出，I S S C C 是各國 I C 設計國力強弱的競技場。二〇〇九年 I S S C C 共錄

取廿三個國家的二〇四篇論文，台灣入選十八篇，全世界排名第三。第一名是美國，有八十九篇入選，第二名日本三十七篇，第四名是韓國十六篇。（資料來源：國家實驗研究院）

Edited 2 time(s). Last edit at 12/29/2009 12:27AM by HP.

HP / December 28, 2009 12:21PM

[IC 產學結合 吳重雨幕後功臣 / 中國時報](#)

[2009-12-28 中國時報](#) 林上祚、劉宗志 / 台北報導

在產業界，台灣成為僅次於美國的全球第二大晶片設計國，從威盛到聯發科，台灣不斷以小搏大，挑戰美商英特爾與高通（Qualcomm）等巨人。而大學研究室設計的晶片能夠透過台積電、聯電量產，是成功的重要關鍵。這樣的產學合作關係，幕後最大功臣是交大校長吳重雨。

一九九一年，吳重雨由交大教授借調國科會工程處，推動成立國家晶片中心，提供價值二千多萬的免費軟體，供教授帶著學生設計使用，設計出的晶片還可就近在竹科台積電、聯電晶圓廠試產。透過這個平台，已有超過一千位教授、數萬名學生，投入國內IC設計領域。

台積電表示，作為台灣半導體業領導廠商，獎勵學術研究絕對有助日後發展。台積電每年在台灣、新加坡、中國大陸舉辦論文比賽，也鼓勵教授與台積電研究部門人員共同發表學術論文。台積電也與交大合辦IC設計競賽，今年有四一二隊參賽，人數居歷屆之冠。

聯發科原以光碟機相關晶片為主力，二〇〇二年轉進手機晶片領域，當時台灣在無線通訊領域技術不足，因此捐助台大電子所成立頂尖無線通訊實驗室。短短數年，手機晶片相關營收已超過總營收五成，取代光碟機晶片營收，成為營收主要來源，與台大的產學合作是重要因素之一。

聯發科也與交大、清大等名校合作成立實驗室，今年已可挑戰全球手機晶片龍頭高通的地位。

搭起產學合作橋梁的最大功臣是吳重雨。他在交大主持的黃金307實驗室在業界非常有名，培育出許多IC設計人才。例如，在類比IC領域發光發熱的包括聯發科副董事長卓志哲、義隆電董事長葉儀皓、通嘉總經理李皓明、華星總經理吳添祥、力原總經理黃振昇、聯發科光儲存總經理呂平信。如今，吳重雨接下交大校長的棒子，台灣IC設計產學合作可望在既有的基礎上，繼續向前走。
